

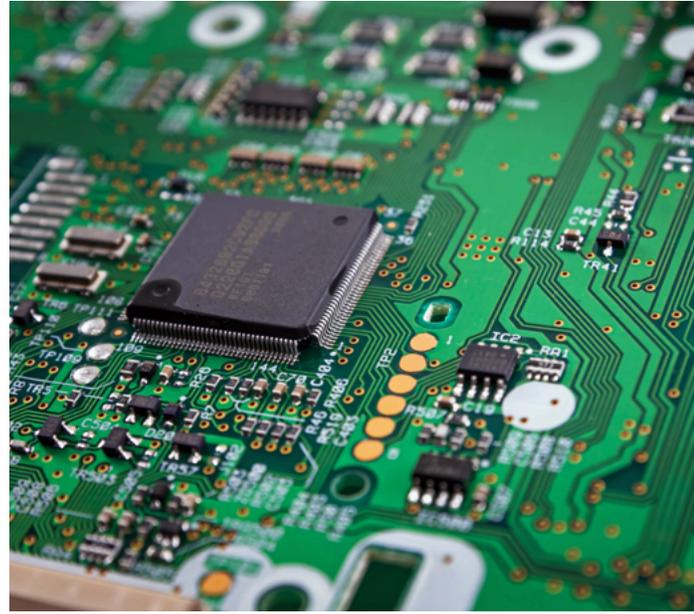
# ORMECON CSN

## 化学沉锡

### 关键应用中值得信赖的可靠性

由于注册专利的预浸技术，ORMECON CSN 化锡制程即使在多次无铅回流焊后，仍具有优秀的焊锡性和外观。该技术使用由 ORMECON 预浸药水所沉积的纳米金属层，该预浸可在应用化学沉锡涂层前起催化的作用。由此产生的大颗粒锡晶粒结构可明显减缓了铜 - 锡金属间的扩散，因此使产品具备行业内最长的保质期。

Dolphin 化学沉锡技术升级至 ORMECON CSN，实现了设备占地面积更小的新生产线，减少停机时间，令镀槽维护的工作更容易。Dolphin 还提高了现有生产线的产量，并增加了最大锡厚度，从而提高了可靠性和生产效率。



### 主要特性优点

- 汽车电子量产验证的行业领先最终表面处理
- 专利的预浸可将铜-锡扩散降低高达65%
- Dolphin 的升级消除了化学分解的杂质，同时实现了均匀的沉积
- 容许多次无铅回流焊装配
- 行业中最长的保质期
- 独特的晶体结构可抵抗锡须的形成

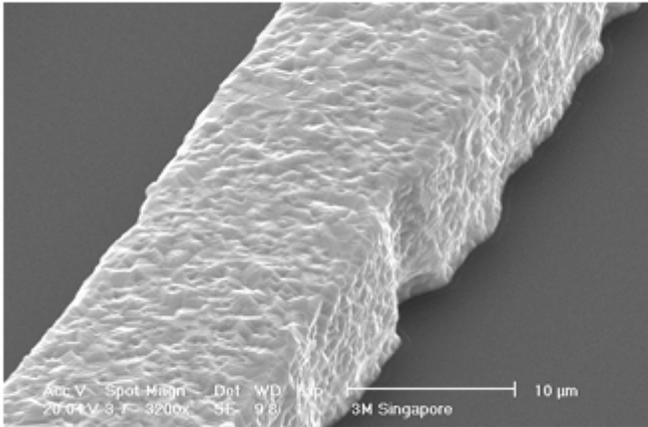


# ORMECON CSN

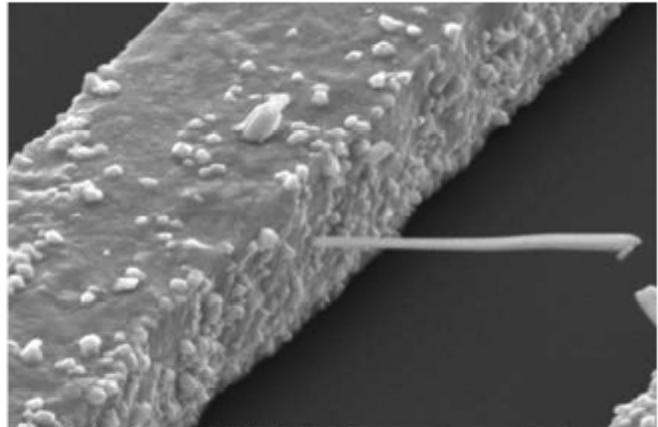
化学沉锡

## 没有其他产品能与ORMECON CSN Classic竞争

Ormecon CSNs 专利的预浸为铜扩散到锡中提供了温和的阻絕層，同时还创造了独特的低应力晶粒结构，大大减少了晶须的形成。



ORMECON CSN Classic 避免锡须形成并提供优秀的焊锡性



竞争对手锡须和焊锡性问题

## 铅回流焊后无与伦比的焊锡性

